

# 神二十三組合體完成轉運 近日擇機發射

【大公報訊】記者劉凝哲北京報導：備受關注的中國空間站神二十三號任務即將正式實施。中國載人航天工程辦公室宣布，5月16日，神二十三號載人飛船與長征二號F遙二十三運載火箭組合體已轉運至發射區。目前，發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，計劃近日擇機實施發射。依照以往慣例，載人飛行任務會在發射窗口前約一周左右完成船箭組合體轉運工作，這意味著正式進入發射準備階段。

16日8時30分許，神二十三號船箭組合體在活動發射平台的托舉下，駛出了總裝測試廠房，通過垂直轉運的方式，平穩駛向發射塔架。隨後，神二十三號船箭組合體已經抵達發射工

位，垂直轉運工作順利完成，這意味著前期火箭和飛船在技術區的總裝和測試工作已經結束，正式進入到發射準備階段。

## 官方已發布飛行任務標識

據報道，神二十三號載人飛船與長征二號F遙二十三運載火箭進駐發射場，技術團隊並行開展了垂直總裝、垂直測試等多項工作。目前，發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，計劃近日擇機實施發射。專家介紹，垂直轉運之後，工作人員會開展三項測試，包括發射區的功能檢查，點火及緊急關機的電路檢查，還有全系統的發射演練，全系統的氣檢及推進劑加注工作。

此前，官方已經發布神二十三號載人飛行任務標識。此次標識與以往有很多不同之處，其中的飛天神女等元素引發輿論廣泛討論。官方表示，標識中三顆五角星對應執行任務的三位航天员；左側以長征二號F運載火箭發射為視覺主體，搭配金色祥雲、如意紋樣，將傳統吉祥元素與現代航天科技相融，寄託任務圓滿成功的美好祝願，彰顯傳統文化與航天事業的深度融合；右側融合「飛天」形象與靈動飄帶，線條昂揚向上，與圓形輪廓相得益彰，以經典文化符號承載中華民族千年飛天夢想與探索蒼穹的堅定信念。識色彩以科技藍為主色調，象徵着太空探索與科技突破；以中國紅點綴，既傳承神舟系列標識視覺基因，也寓意着任務順利、一往無前。



▲5月16日，神二十三號載人飛船與長征二號F遙二十三運載火箭組合體轉運至發射區。 新華社

## 加快擺脫對美國芯片依賴 黃仁勳最擔心的事發生了！

# DeepSeek 適配昇騰 「國模+國芯」逆襲

英偉達公司首席執行官黃仁勳最擔心的，是中國本土AI基礎設施從依賴美國半導體轉為依賴中國國產芯片。如今，黃仁勳最擔心的事發生了！

近日，DeepSeek V4模型首次實現與華為昇騰等國產芯片深度適配，擺脫了對美國芯片的依賴。隨後，寒武紀、摩爾線程等國產AI芯片廠商也宣布與科企完成適配。這標誌着大模型與國產算力之間的協同進入了「同步起跑」的新階段，依託本土硬件搭建AI算力底座的「國模+國芯」方案加速成型。

大公報記者 郭瀚林北京報導



▲近日，DeepSeek V4模型首次實現與華為昇騰等國產芯片深度適配，擺脫了對美國芯片的依賴。左圖為觀取在西班牙世界移動通信大會上參觀華為公司展示的Atlas 950 SuperPoD超節點；右圖為人們在杭州市文三數字生活街區體驗DeepSeek大模型。 新華社

近年來，美國屢屢推出AI芯片出口管制政策，旨在掌握全球AI基礎設施建設的控制權。今年1月，特朗普政府對H200對華出口的有條件批准，並要求英偉達將相關銷售收入的25%上繳美國政府。不過，該產品在國內頭部企業集體冷遇，H200芯片獲批出口後出現兩個月在華零銷量局面。同期，華為昇騰910P芯片價格則逆勢上漲20%，訂單數量達數十萬顆，產能滿載。中國AI產業正在實現從算法到硬件的「自給自足」，動搖美國以壟斷和禁運建立起的對華封鎖牆。

## 中外產品並立 多元技術並進

國際數據公司此前發布資料顯示，英偉達在華市場佔有率已由三年前的95%以上驟降至2025年的55%。2026年第一季度，中國AI芯片市場規模同比增長超80%，國產芯片市場份額首次過半。華為、寒武紀、崑崙芯等廠商正加速構建涵蓋芯片—集群—模型適配的完整生態體系，形成「中外產品並立、多元技術路線並進」競爭格局。多家機構預測，華為昇騰系列2026年或將佔據中國AI芯片市場半數份額。摩根士丹利發布報告則認為，到2030年中國AI芯片自給率將達到86%，潛在總體市場規模達670億美元。

「從產業影響來看，H200的放開側面印證了國產算力芯片性能的進步。」北京約瑟投資有限公司董事長兼總裁陳九霖接受記者採訪時表示，產業自主可控化當前已經成為國內共識，技術層面的國產替代方案逐漸成熟、供應鏈日益完善。他指出，美國出口管制流程繁瑣、政策走向高度不確定，使AI企業在算力中心建設等重資產投入中，更重視供應商可靠性與持續交付能力。「今天可以賣給你，明天就搞卡脖子，誰會對你放心？英偉達想要再現昔日榮光，特別是在市場份額方面「收復失地」並不容易。」

## 國產芯片從「可用」轉向「好用」

4月，深度求索公司發布DeepSeek-V4預覽版，並同步開源。在核心技術方面，DeepSeek-V4原生支持100萬Token上下文，並大幅降低計算與顯存需求，推理成本顯著下降。值得注意的是，大模型首次把華為昇騰芯片和英偉達芯片並列寫進硬件驗證清單，適配的華為昇騰新款推理芯片，採購價格僅為英偉達的四分之一，性價比優勢十分突出。

除華為外，DeepSeek-V4發布後，寒武紀、摩爾線程等多家國產芯片廠商完成了Day0適配。所謂Day0指大模型上線當天，算力已完成全鏈路兼容、性能優化與穩定性驗證，開發者開箱即用，無需額外等待。在過去，只有英偉達能做到這一點，其他GPU往往滯後數月。

芯謀研究企業部總監王笑龍接受媒體採訪時表示，隨着中國半導體產業自主可控戰略深入推進，雖然工藝製程仍部分程度受限，但國內產業鏈仍能通過「適度製程+先進封裝+系統和生態優化」走出一條中國特色半導體發展路徑。他指出，DeepSeek、千問等國產大模型出圈背後，是國產AI芯片在利用效率上的提升，良好的軟件生態對硬件的利用效率，將加速國產AI芯片從「替代可用」向「自主好用」的進程。

## 國產AI芯片從「推理」走向「訓練」

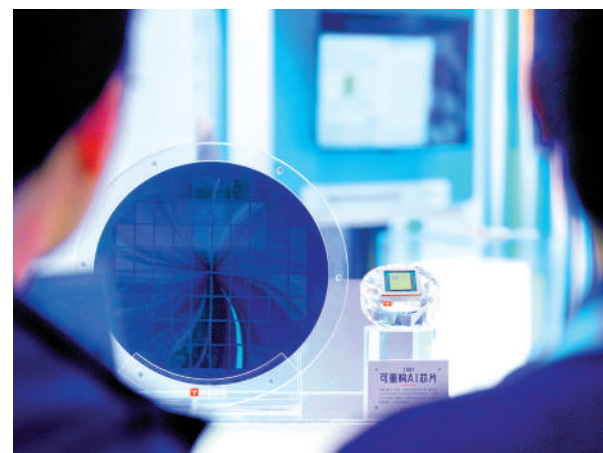
體系崛起

國產AI芯片正從推理側的「單點突破」，邁向訓練側的「體系化崛起」。今年以來，一批基於國產芯片訓練的AI大模型密集落地，標誌着國產算力在訓練場景的實戰能力得到驗證。業界認為，2026年將成為「國產AI芯片訓練落地元年」。

## 能應對複雜多模態任務

今年1月，智譜聯合華為開源新一代圖像生成模型GLM-Image。該模型基於華為昇騰Atlas 800T A2設備與昇思MindSpore AI框架，完成從數據處理到模型訓練的全流程閉環，是首個依託國產芯片實現全程訓練的SOTA（當前最高水平）多模態模型，首次讓國產芯片訓練的模型站上國際頂端舞臺。

此外，摩爾線程與北京智源人工智能研究院已成功完成智源自研具身大腦模型RoboBrain 2.5的全流程訓練。這一成果首次驗證了國產算力集群在具身智能大模型訓練中的可用性与高效性，標誌着國產AI基礎設施已具備應對複雜多模態任務的能力。據國家海關總署公布外貿數據，今年1-2



▲在北京中關村展示中心常設展上，參觀者在了解清微智能公司展示的可重構AI芯片。 新華社

月中國集成電路出口額達433億美元，同比暴漲72.6%，遠超同期中國整體出口21.8%的增速。其中，東盟已成為中國芯片第一大直接出口市場，今年1-2月佔比達29.7%，增速高達128%。

值得注意的是，集成電路出口金額的大幅增長，是「量價齊升」而非「以價換量」。按照海關總署公布的數據，今年前兩月，中國集成電路出口數量僅增長13.7%，意味着平均單價上漲了52%。國產芯片正式邁入高附加值「出海」階段。 大公報記者郭瀚林

## 2025年中國AI芯片市場份額

- 英偉達：55% (約220萬顆)
- 華為昇騰：20% (約81.2萬顆)
- 阿里平頭哥：6.6% (約26.5萬顆)
- AMD：4% (約16萬顆)
- 寒武紀：3% (約11.6萬顆)
- 百度崑崙芯：3% (約11.6萬顆)
- 海光信息：2% (約8.25萬顆)
- 沐曦股份：1.7% (約6.6萬顆)
- 天數智芯：1.3% (約4.95萬顆)
- 其他：3.4%

## 國產芯片廠商與DeepSeek-V4適配情況

- **華為昇騰：**昇騰A2、A3及950全系列產品適配DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash。昇騰950通過融合kernel和多流並行技術降低Attention計算與訪存開銷，大幅提升推理性能，結合多種量化算法，實現高吞吐、低延遲的推理部署。
- **寒武紀：**基於vLLM推理框架完成Day0適配，適配代碼已開源至GitHub社區，支持DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash。
- **海光信息：**海光DCU（深算系列）完成對DeepSeek-V4的Day0適配，並對模型進行深度調優，形成「模型發布—芯片適配—產業落地」的閉環，提供即取即用的部署。
- **摩爾線程：**摩爾線程聯合北京智源人工智能研究院，基於旗艦級AI訓練一體智算卡MTT S5000與FlagOS全棧軟件體系，完成DeepSeek-V4系列兩款模型推理Day0適配，並在魔搭社區正式發布Pro和Flash兩個版本的鏡像，為開發者與行業用戶帶來開箱即用的國產化部署方案。

前景可期

中國產業發展促進會產業創新集群副秘書長王彬接受記者採訪時表示，當前中國芯片產業已度過了最艱難的「卡脖子」階段，進入了聚焦「生態建設」和「規模化應用」的新周期。在AI大模型、智能駕駛、機器人等新興和未來產業的應用領域，國產芯片已從「替代者」逐漸向「引領者」過渡。

## 國產算力生態全鏈打通

「過去，國產芯片最大的痛點不是算力不夠，而是『無人適配』——大模型廠商優先適配英偉達CUDA生態，國產芯片只能在發布後幾個月甚至半年才能獲得支持。」王彬談到，DeepSeek V4大模型發布當天，華為昇騰等主流國產AI芯片廠商全部完成了Day0適配，代碼直接開源。這是國產算力生態第一次

## 國產芯片已度過最艱難「卡脖子」階段

在頂級商用模型上實現「主動納入、全鏈打通、開源背書」。如今，大模型與芯片的關係正在從「芯片等模型」變成「模型等芯片」，頭部大模型廠商在研發階段就會與國產芯片廠商深度合作，針對芯片架構進行專門優化。這種「軟硬協同」的模式，正在快速縮小與英偉達CUDA生態的差距。

他表示，從應用場景看，國產芯片的市場前景更加不可限量。

在汽車領域，國產智駕芯片不僅在成本上比海外芯片低30%-50%，更重要的是能夠針對中國複雜的交通場景進行專門優化，並且支持數據本土處理，完全符合數據安全法要求。在機器人產業，具身智能催生了「泛機器人芯片」新賽道。未來3-5年，「泛機器人芯片」將成為繼智駕芯片之後國產芯片的又一個萬億級市場。 大公報記者郭瀚林